

安泰銀行主辦立敦科技新臺幣 7 億元聯貸案 獲 7 家銀行團超額認購 1.2 倍

安泰商業銀行(股票代號 2849，以下簡稱「安泰銀行」或「本行」)統籌主辦立敦科技股份有限公司(股票代號 6175，以下簡稱「立敦科技」)新臺幣 7 億元五年期聯貸案，已成功完成募集。簽約儀式於今日由立敦科技董事長吳德銓先生與安泰銀行法人金融總處長張懷恩先生共同簽署，本次聯貸共同主辦行為臺灣土地銀行，參貸銀行有台新銀、兆豐銀、第一銀、華南銀及台企銀。

近期電子產品對鋁質電容的需求暢旺，帶動對上游原料化成鋁箔的需求，立敦科技業績順勢轉佳，在營運成長及獲利大幅改善下，此聯貸案吸引 7 家銀行參與，超額認貸達 1.2 倍，但仍依原預計籌組額度新臺幣 7 億元簽約，充分顯示金融同業對立敦科技高度肯定與支持，本次聯貸資金將用於償還金融機構借款暨充實營運週轉金以及購料週轉金所需。

立敦科技於民國 82 年 11 月成立，以產銷化成鋁箔為主要業務，主要產品化成鋁箔及電解液為鋁質電解電容器之主要原料。該公司為國內化成鋁箔製造與銷售之專業廠商，營運初期自日本引進生產技術，民國 92 年與永剛科技合併後，成為國內唯一擁有中高壓電蝕鋁箔生產技術及量產能力之公司。立敦科技受惠於下游鋁質電容需求強勁，加上良率提升、調整產品組合至中高壓鋁箔，增加產品競爭力，並調升價格等正面效益發酵下，前景轉佳。四川阿壩州廠產能陸續開出，在電力成本降低下，營運及獲利可望呈現爆發性成長。

安泰銀行今年以來整體表現卓越，在法人金融核心產品市場方面，聯貸、貿易服務與貿易融資、應收帳款承購業務及法人信託業務，都有極大的成長。未來除延續深耕原有之企金客戶關係外，並將重點開拓中小型企業客戶之業務版圖，以創造企業與銀行共贏局面。